

「なぜ失敗したかわからない」を終わらせる。

真空、加圧、制御により再現性ある実験環境を構築



開発専用  
小型  
真空リフロー炉

COMPACT VACUUM NITROGEN REFLOW OVEN  
TR-200-300

ボイドの減少  
酸化防止  
高速温度制御

外注なしで、社内でここまで検証できる。

小ロット評価や比較試験を自社内で進めやすい卓上設計。

真空・窒素・温度プロファイル対応で、  
開発のスピードと質を向上させます。

Point 01

社内で素早く条件出し

外注待ちをゼロに。卓上設置・  
省スペースで、試験サイクルを  
大幅に短縮します。

Point 02

真空・窒素で品質評価

ボイド低減、酸化抑制を精密  
制御。接合品質の評価・比較  
検証が可能です。

Point 03

購入前に適合性確認

導入前に自社ワークでの検証  
が可能。失敗しない装置選定  
をサポートします。



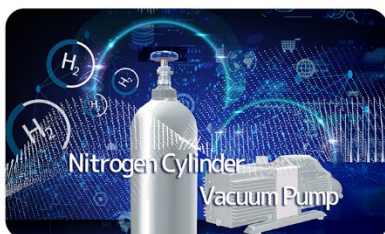
ワークの状態が見える



● 観察しながら評価できるため  
ハンダ付けのプロセスを  
リアルタイムで確認可能。



真空・窒素パージ



● 真空引きと窒素パージに対応。  
雰囲気コントロールした高度  
な評価・実験が可能。



温度プロファイル



● 条件に応じた温度プロファイルを  
自在に設定でき、再現性の高い  
評価・検証を実現。

# 研究開発現場で選ばれる理由

## 1 真空・窒素・温度プロファイル対応

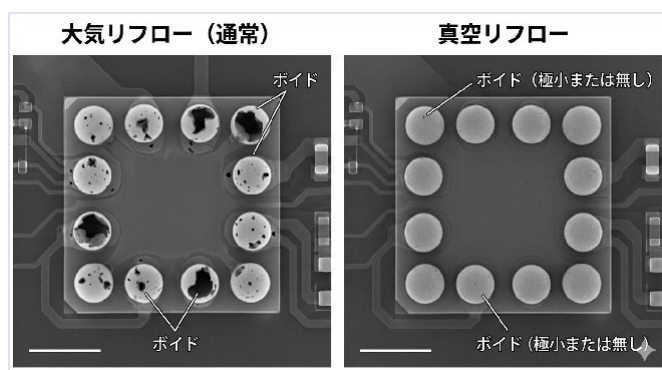
真空度0.1MPa、酸素濃度1%以下を実現。ボイド発生や酸化を抑制し、高品質な接合状態を社内で再現・評価できます。

## 2 条件出しの内製化、試験サイクル短縮

卓上設置で即稼働。外注に出さずに仮説検証を素早く行い、研究開発のスピードを飛躍的に向上させます。

## 3 購入前に自社ワークで適合性確認可能

「自社の材料で使えるか」を事前に確認できるよう、来社デモ(無料)や受託試験(有償)の体制を整えております。



真空雰囲気によるボイド低減効果

主要スペック TR-200-300



窒素パージによる酸化抑制効果

対象ワーク・評価用途

チャンバー有効内寸	W170 × D170 × H20 mm
最大昇温速度	120°C/min
最大降温速度	80°C/min
温度分布	±4°C
酸素濃度	1%以下
真空度	0.1MPa
制御プログラム	8プログラム × 16ステップ
外形寸法	W520 × D370 × H192 mm
本体重量	22.5 kg

BGA      フリップチップ      パワー半導体

はんだ      フラックス      Ag焼結材

微細接合の再現性確認、電子部品の実装評価における不良抑制、材料変更時の比較試験等、幅広い研究開発テーマに対応します。

 **株式会社タイセー**

〒273-0104 千葉県鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷3丁目23番地54号

TEL: 047-446-2221 (代表) / FAX: 047-446-2131

<https://www.e-taisei.co.jp/>

お問い合わせ: [info@e-taisei.co.jp](mailto:info@e-taisei.co.jp)